



# 회사소개서

# Contents

## 1 회사 소개

- 회사 개요
- 조직도
- 연혁 및 매출액
- 사업분야

## 2 제품 소개

- 공정장비
- 검사장비
- X-RAY System

## 3 별첨

- 특허 및 인증현황
- 주요 고객사

# 1 회사 소개

“ 세상을 바라보는 눈, SEE INSIDE 입니다.”

‘SEE INSIDE’는 급변하는 자동화 환경에 맞춰 발 빠른 비전 솔루션을 제공하기 위해 노력 하고 있습니다.

고객과 같은 곳을 바라보며 함께 나가는데 목표를 지향하고 있습니다.

(주) SEE INSIDE는 급변하는 산업 환경에 선제적인 대응과 기술력의 구현으로 고객의 경쟁력을 높일 수 있는 PARTNER가 되겠습니다.



회 사 명 : 주식회사 씨인사이드

대표이사 : 김 솔찬

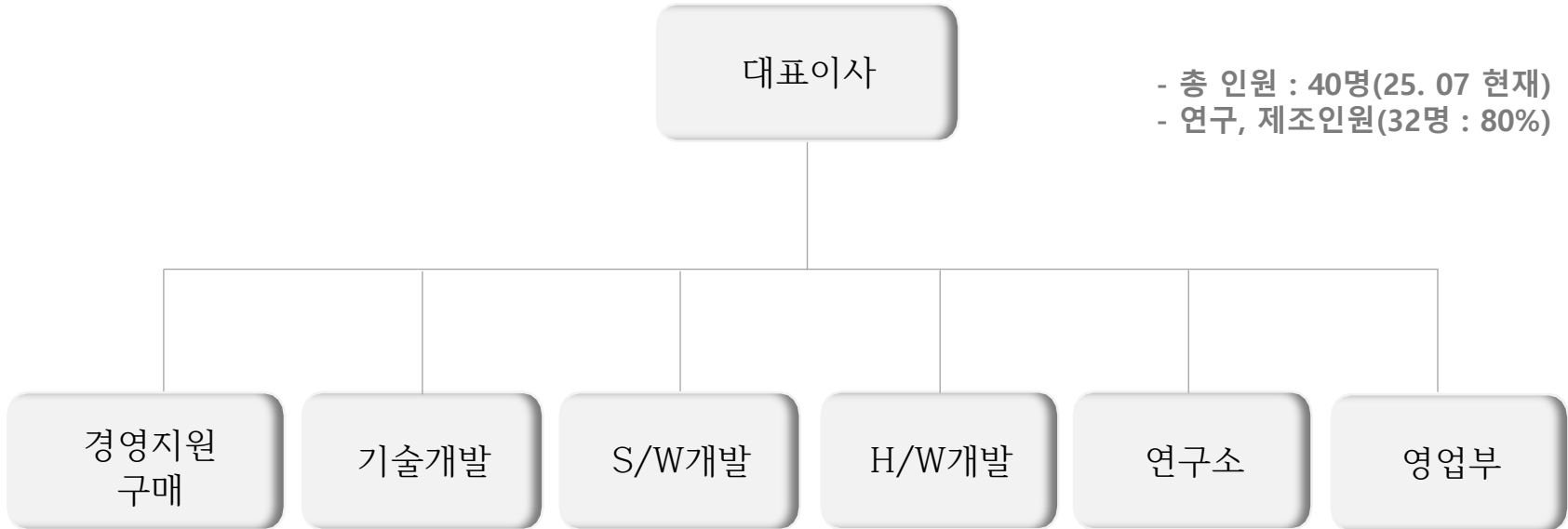
설 립 일 : 2021년 10월

주요업무 : 영상처리검사장비 및 시험장비

주 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 234 (성곡동)

전 화 : TEL 032-433-1304 FAX 032-213-1304

홈페이지 : [www.seeinside.co.kr](http://www.seeinside.co.kr)



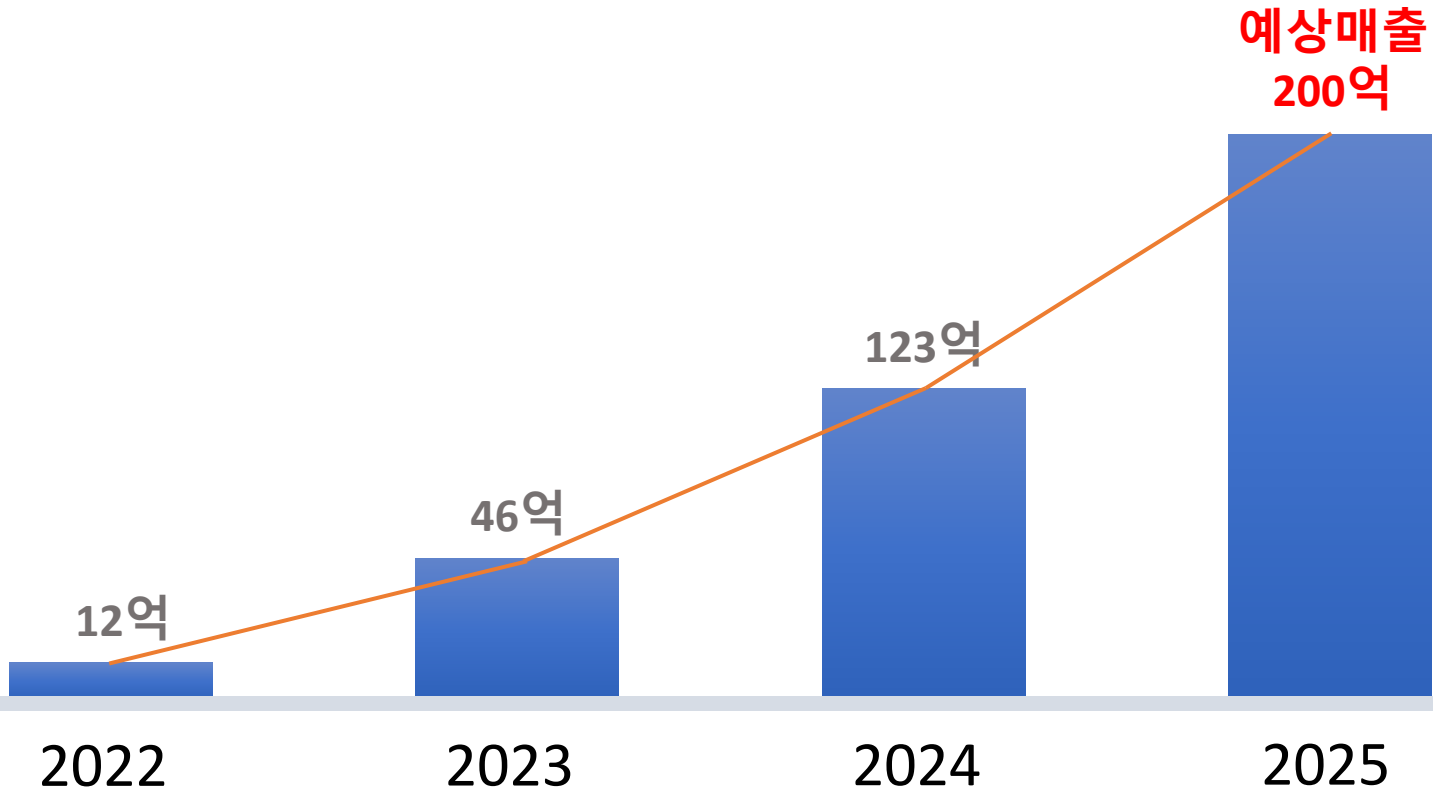
- 총 인원 : 40명(25. 07 현재)
- 연구, 제조인원(32명 : 80%)

(주) 씨인사이드는 설립부터 지금까지 임직원의 약 80% 이상이 엔지니어로 구성 되어 있으며 고객사의 생산 환경에 맞춘 Vision System 및 자동화 설비 **TOTAL SOLUTION** 을 제공하고 있습니다.

광학계 구성 소프트웨어 개발, 기구 설계 까지 고객 사의 요청에 맞춰 모든 System의 Customizing 이 가능합니다.

모든 프로젝트에 PM을 배치하여 실시간 대응을 하고 있습니다.

# 연혁 및 매출액



- 기업 창업
- 기업 부설 연구소 설립

- 안산 지점 공장 설립
- 배터리 캔 검사 개발
- OLED 시스템 개발
- 반도체 검사 시스템 개발

- 디스플레이 설비 납품
- 웨이퍼 프리얼라이너 양산
- 사업 매출구조 다각화 수행
- 반도체 2D&3D AOI 개발

- 모바일 부품 AOI 납품
- 반도체 패키징 AOI 데모
- 2차 전지 부품 AOI 납품
- 디스플레이 라인 증설
- 전장 부품 AOI 개발

## 개요

### 반도체 관련장비

- Unloader System
- 2D/3D AOI System
- SWIR Inspection System
- Pre-Align System
- Laser Marking System
- Stacker System
- Metal Mask AOI System

- 전공정에 사용되는 시각자동화 검사장비의 경우 Sub-micron 대의 미세한 크기의 결점들을 검출하는 시스템

### 2차 전지 및 자동차

- CAN Inspection
- CID Inspection
- Curling Vision
- CDN Vision
- KAC Stopper Vision System
- Head Light Inspection

- 다양한 크기와 형태의 배터리를 검사하기 위한 높은 수준의 광학 조건 및 치밀한 검사 환경 조성을 통한 제품의 결함 검출

### 디스플레이

- UTG Inspection
- Epoxy 유,무 검사
- 제품 외관 검사
- AOI System

- 100% 전수 검사를 실시하는 각 Panel의 생산 공정간 검사를 통한 빈도/정밀도 높이는 동시에 검사 소요시간 최소화

### X-RAY 검사장비

- 2차전지 Align Vision
- IC CHIP 내부회로 검사
- Lead Pin 내부 검사
- 불투명 용기 內 용량 검사
- 불투명 알약 검사
- 식품 검사
- 타이어 검사

- 1 $\mu$ m 미세 불량 검출 가능하며, 강한 투과력으로 내부에 있는 불량 및 검출 대상의 관찰 가능

반도체, 디스플레이, 2차전지 등에 최적화된 비전시스템 설비 및 이를 위한 기구설계, 제작, 자동제어와 sw에 관한 핵심기술 보유를 통해 최적의 솔루션을 제공해 드립니다.

## 비전 시스템



## 공정 설비



## 자동 제어



## 머신 비전

- 객체분할, 개체분할, 문자판독 소프트웨어 개발
- 물류라인 제품 얼라이먼트 비전
- 로봇 비전 가이드

## 공정자동화

- 기구/전장 설계, 자체기구 제작, 전장 배선 및 셋업 기술
- 다축 서보모터 제어 기술
- 데이터 베이스 프로그램 (MySQL)
- 생산 라인 물류 관리 프로그램

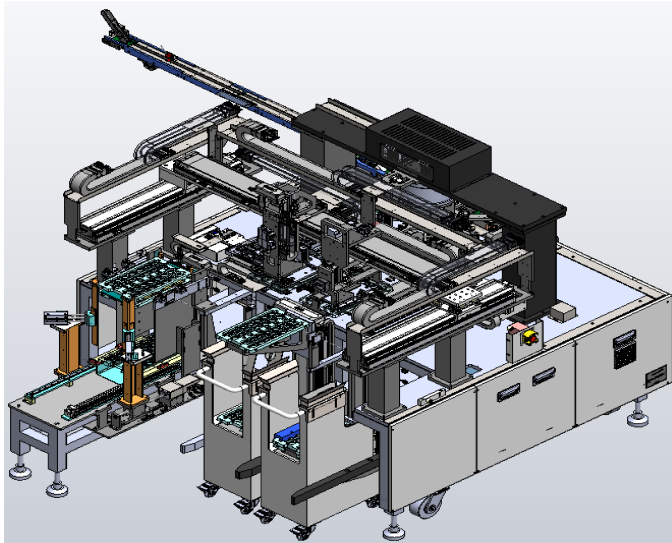
## PLC 및 통신제어

- MITSUBISHI PLC, LS PLC 제어기술
- CIM 프로그램 및 생산 라인 물류 제어
- 프로그램 개발

## 2 제품 소개

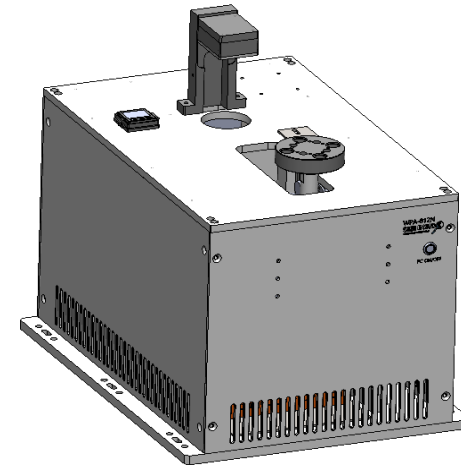
## 공정 자동화 관련 장비

### Pick & Place System



· UPH	6K
· 적용분야	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tray to Tray</li> <li>- Wafer to Tray</li> <li>- etc</li> </ul>

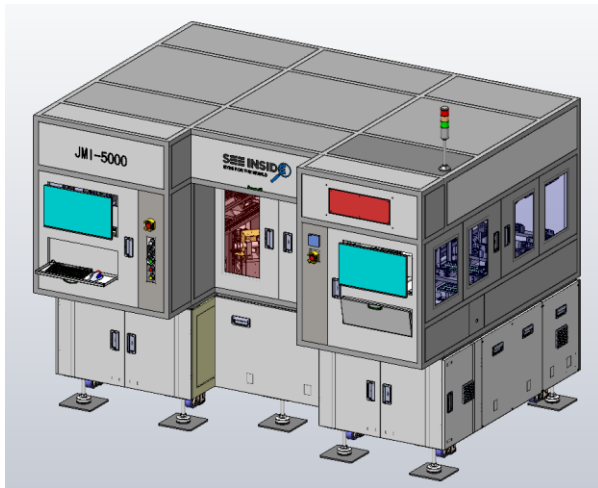
### Wafer Align System



· WAFER Type	Transparent, silicone, plastic, Film
· WAFER Size	Ø300mm, Ø200mm
· Alignment Accuracy	Centering : $\pm 0.05\text{mm}$ Rotation : $\pm 0.05^\circ$
· Alignment time	Within 4 seconds
· Alignment sensor	Vision Camera
· 적용분야	Wafer 전 공정

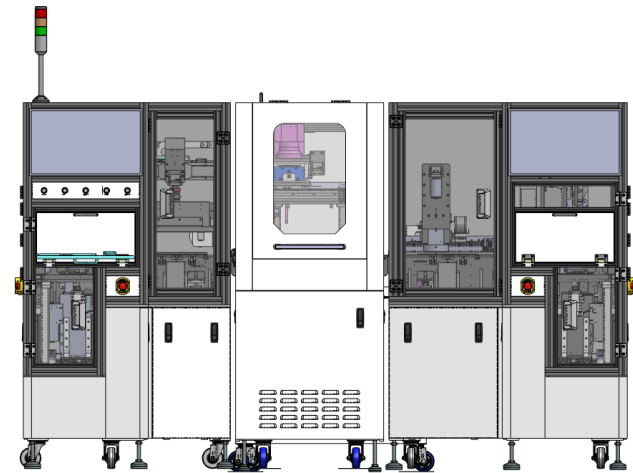
## 공정 자동화 관련 장비

### Tray Laser Marking System



· UPH	Optional - 2.8K ( Single Head ) - 5.6K ( Dual Head )
· 적용분야	- FCBGA - Wafer - Etc

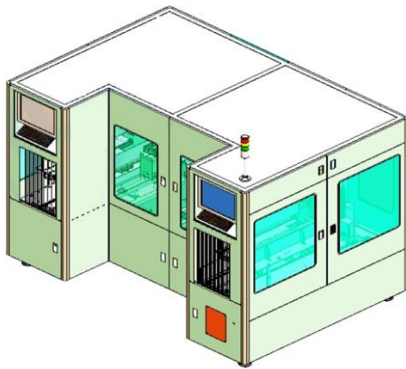
### Strip Laser Marking System



· UPH	Optional - 6K ( Single Head ) - 12K ( Dual Head )
· 적용분야	- PCB - Wafer - Etc

## 공정 자동화 검사 장비

### IR Inspection System



· Inspection ITEM

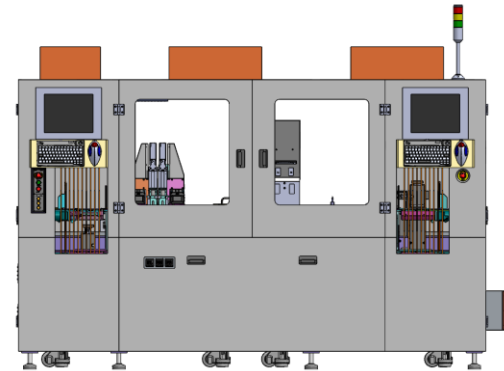
- Wafer Backside Crack
- 표면실장 Die Backside Crack



· 적용분야

- Wafer 관련 All

### Wafer AOI System

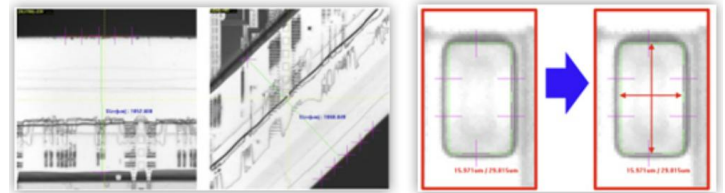


· Inspection ITEM

- Wafer 표면 이물, S/C, 오염
- ETC

· Application Package

- Wafer

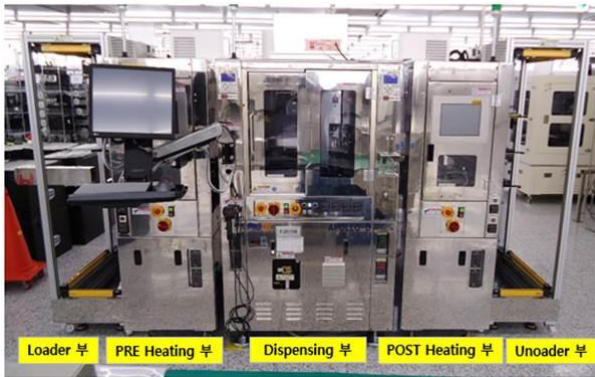


· 적용분야

- 표면실장 전 공정
- Wafer 공정

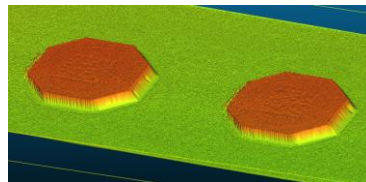
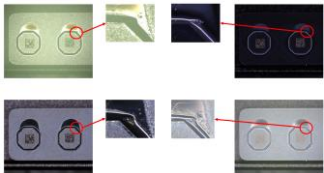
## 공정 자동화 검사 장비

### Underfill Inspection System



· Inspection ITEM

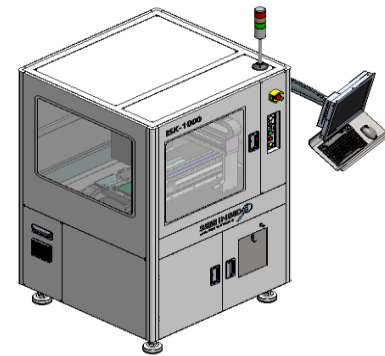
- Over flow
- Resin bleed out
- FM
- ETC



· 적용분야

- Underfill 공정

### 2D&3D AOI System



· Inspection ITEM

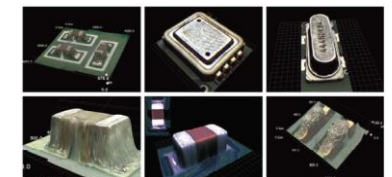
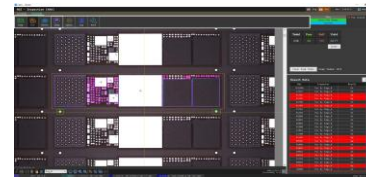
- 부품 Crack, S/C, 오염 등
- 부품 높이

· Machine Type

- Inline & Stand alone

· Application Package

- Strip & Tray & Wafer

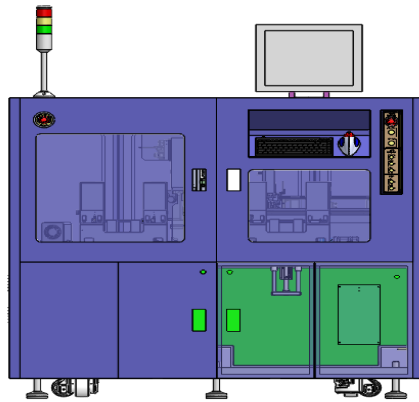


· 적용분야

- 표면실장 전 공정
- Wafer 공정

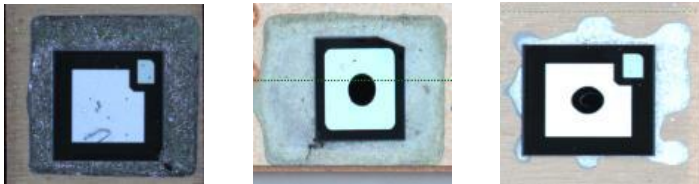
## 공정 자동화 검사 장비

### Die Attach Inspection System



· Inspection ITEM

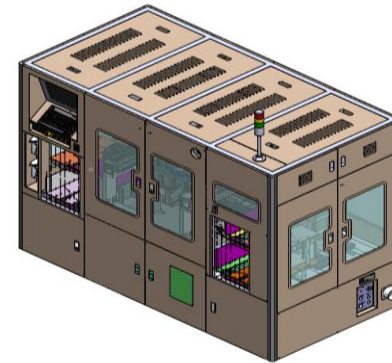
- Die Crack
- S/C
- 오염
- ETC



· 적용분야

- Semiconductor All
- ETC

### EOL Molding 2D & 3D AOI System

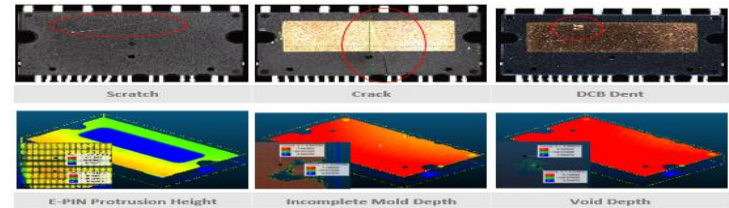


· Inspection ITEM

- Mold S/C, Copper Dent
- Position offset
- ETC

· Application Package

Strip & Tray

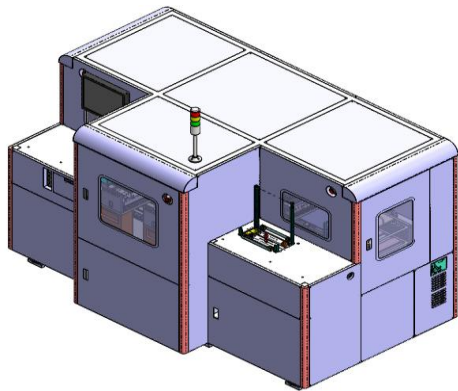


· 적용분야

- Mold package 전 공정

## 공정 자동화 검사 장비

### Die Attach Inspection System



· Inspection ITEM

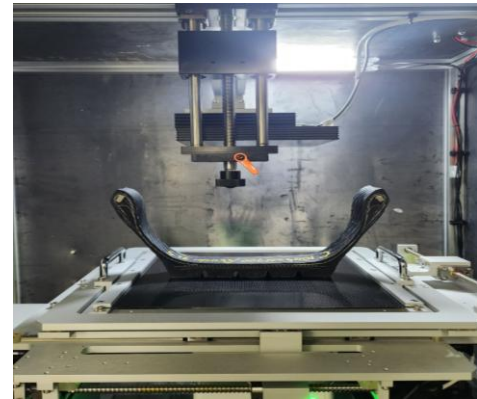
- Package height



· 적용분야

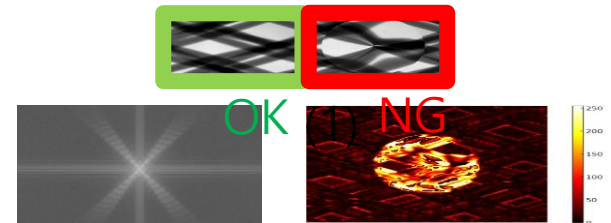
- Semiconductor All  
- ETC

### X-ray System



· Inspection ITEM

- Inner inspection All



· 적용분야

- Semiconductor  
- 2차전지 & Tire  
- ETC

# 3 별첨

# 특허 및 인증 현황

## 특허

출원 번호	명칭	상태
10-2022-0119996	로드 감지 시스템	특허
10-2022-0003660	효율적 반도체 모듈 불량률 검사 할 수 있는 모듈검사 장치	출원
10-2022-0003661	이차 전지용 전극의 결함을 검출하기 위한 비전 검사 시스템	출원
10-2022-0003662	이차 전지의 초음파 용접 상태를 효율적 검사하는 비전 검사 시스템	출원
10-2022-0119995	배터리 캡 비전 검사 시스템	출원
10-2022-0119994	광학 필름 접착 검사 장치	출원

## 인증 현황



[벤처기업]

[벤처기업 회원증]

[연구소 인증서]

[굿컴퍼니 대상]

[고객감동혁신대상]

[인천 패스트파인 대상]

# 주요 고객사



“ 씨인사이드는 신뢰와 협력을 바탕으로,  
글로벌 선도 기업들과 함께 성장하고 있습니다. ”

